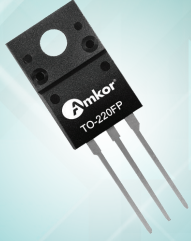


TO-220FP

TO-220FP (Full Pak)는 Cu 클립 구조를 통하여 방열 효율성이 더 뛰어나도록 만든 TO-220의 Full Pack 버전이며 기존의 TO-220NIS 패키지와 비교하여 실장 높이가 2.8 mm 감소했습니다.



Features

- ▶ 개선된 방열 효과를 위한 Cu 클립 인터커넥트
- ▶ 표준 TO-220NIS 대비 실장 높이가 2.8 mm 짧아진 패키지
- ▶ 턴키 테스트와 패키지 서비스
- ▶ 친환경 재료 : 무연 도금 & 무할로겐 몰드 화합물

New Developments

- ▶ 더 크고 집적도가 높은 리드프레임 스트립
- ▶ 친환경 무연 솔더 페이스트

Process Highlights

- ▶ 비도금 Bare copper 리드프레임
- ▶ 인터커넥트 : 전기적·방열 성능 개선을 위해 Cu 클립 사용
- ▶ 도금 : 100% matte Sn
- ▶ 마킹 : 펜 타입 레이저

Applications

TO-220FP는 다음의 중·고전압 MOSFET 및 IGBT에 적합합니다.

- ▶ 스위칭 전원 공급 장치
- ▶ AC 어댑터
- ▶ 모터 드라이버
- ▶ 평면 패널 디스플레이

Reliability Qualification

앰코의 디바이스는 신뢰성이 입증된 반도체 재료로 제조됩니다.

- ▶ 고온·고습도 방치(THS) : Ta = 85°C/Rh = 85%, 1000 hrs
- ▶ 고온방치(HTS) : Ta = 150°C, 1000 hrs
- ▶ 압력방출 : Ta = 121°C/Rh = 100%/P = 2 atm, 100 hrs
- ▶ 온도 사이클 : -45~150°C, 1000 cycles

Test Service

앰코는 모든 Power discrete 제품에 대해 완전한 턴키 비즈니스를 제공합니다. 또한 MOSFET 등 다양한 유형의 전력 디바이스를 테스트할 수 있는 능력이 있습니다.

- ▶ 앰코의 Power discrete 테스트 능력 :
 - ▷ 정적 테스트(DC)
 - ▷ 동적 테스트(AC, Switching/Trr, Capacitance/Rg)
 - ▷ 파괴 테스트(Inductive load/VSUS, I Latch, Surge, Isolation/VIL)
 - ▷ 열 저항(ΔVDS , ΔmV , etc.)
- ▶ 프로그램 생성/변환
- ▶ 불량 분석
- ▶ 뛰어난 테스트/핸들링 기술
- ▶ 통합된 마킹, 육안 검사 및 테이프 릴 서비스

TO-220FP

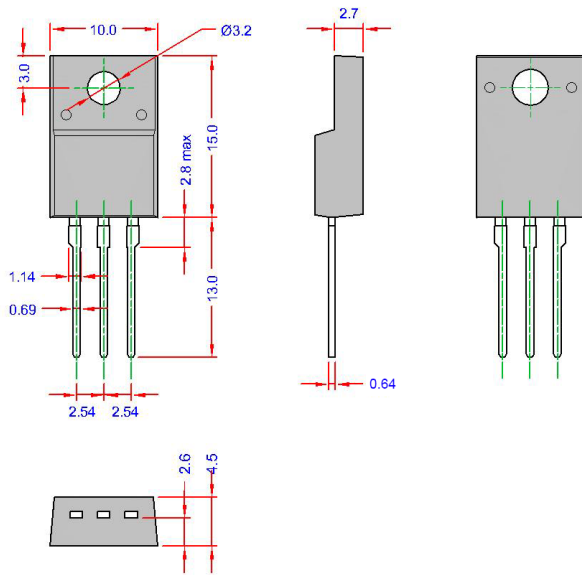
Standard Materials

- ▶ 리드프레임 : Bare copper
- ▶ 칩 어태치 : 솔더 페이스트
- ▶ 인터커넥트 : 듀얼 Cu 클립
- ▶ 몰드 화합물 :
 - ▷ 할로겐과 무할로겐

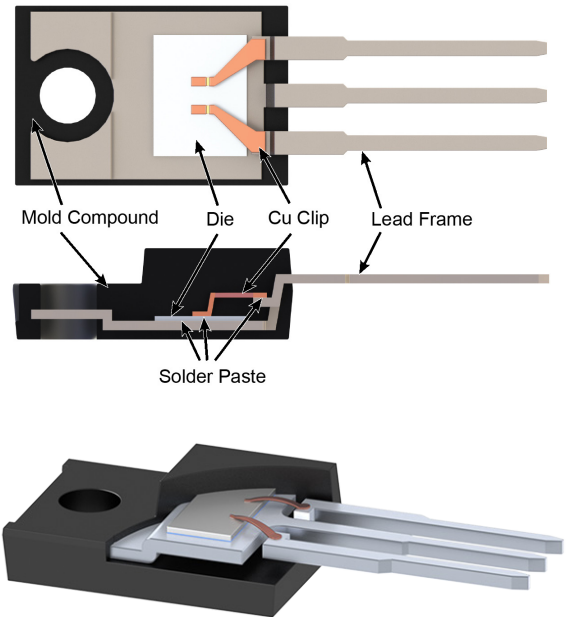
Shipping

- ▶ Tube 또는 loose 패키징
 - ▷ Tube = 박스 당 표준 제품 2500개
 - ▷ Loose = 박스 당 500개
- ▶ 바코드 패키징 라벨
- ▶ Drop ship

Package Outline Drawing



Cross-section



자세한 내용은 amkor.com을 방문하거나 ATKQnA@amkor.co.kr로 이메일을 보내십시오.

본 문서의 모든 콘텐츠는 저작권법에 따라 무단복제 및 배포를 금지하며, 제공된 정보의 정확성을 보장하지는 않습니다. 앰코는 본 문서의 정보사용에 따른 특허나 라이선스 등과 관련된 어떠한 형태의 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서는 앰코의 제품보증과 관련하여 표준판매약관에 명시된 것 이상으로 확대하거나 변경하지 않습니다. 앰코는 사전고지 없이 수시로 제품 및 제품정보를 변경할 수 있습니다. 앰코의 이름 및 로고는 Amkor Technology, Inc.의 등록상표입니다. 그 외 언급된 모든 상표는 각 해당 회사의 자산입니다. © 2018, Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved. DS610C Rev Date: 10/18

